

# 2017-2023年中国印制电路板行业市场运营态势及 投资前景预测报告

报告大纲

## 一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2023年中国印制电路板行业市场运营态势及投资前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/323967.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

2010年，随着中国等新兴经济体PCB行业率先从金融危机的影响中恢复增长，各个国家和地区PCB产业相继止跌回升，当年全球印制电路板行业总产值达到524.68亿美元，较上年增长27.3%。根据Prismark的统计及预测，2011年全球PCB产值达到554.09亿美元，较2010年增长5.6%，虽然受欧美经济持续疲软、全球经济恢复低于预期的影响，2012年全球PCB产值较上年下滑2.0%，至543.10亿美元，但是据预计，2012-2017年期间，全球PCB产值将保持年均复合增长率3.9%的速度稳定增长，在2017年整体规模将有望达到656.54亿美元。2009-2017年全球PCB行业发展情况及未来趋势

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。报告目录：第一章印制电路板制造行业概述.20第一节印制电路板制造行业概况.20一、印制电路板简介.20二、印制电路板基本组成.20三、印制电路板产品分类.21四、印制电路板生产流程.21第二节印制电路制造产业链简介.22第三节印制电路制造产业链上游分析.22一、玻纤纱/布市场情况分析.22（一）玻纤纱/布市场供给分析.22（二）玻纤纱/布生产分布分析.23（三）市场价格影响因素.24二、环氧树脂（EP）市场情况分析.25（一）环氧树脂（EP）概况分析.25（二）环氧树脂（EP）生产情况.25（三）环氧树脂（EP）消费分析.25三、铜箔市场情况分析.26（一）铜箔生产供应情况.26（二）铜箔市场需求分析.27（三）铜箔行业发展特点.28四、覆铜板市场情况分析.28（一）覆铜板市场发展状况分析.28（二）覆铜板材料成本构成分析.29（三）覆铜板行业发展特点分析.29（四）覆铜板行业发展对策建议.29第四节印制电路制造产业链下游分析.30一、消费电子.30二、计算机.30三、通信设备.30四、工业控制及医疗仪器.30五、汽车电子.31六、国防及航天航空.31第二章世界印制电路板市场发展分析.32第一节世界印刷电路板产业发展分析.32一、印制电路板制造发展历程分析.32二、世界印制电路板产业规模分析.34三、全球PCB配套行业产业规模.34（一）PCB设备市场规模分析.34（二）PCB外形加工设备规模.35（三）PCB检测设备市场规模.36（四）PCB辅助材料市场规模.36四、世界PCB产业竞争格局分析.37（一）世界PCB产业总体竞争格局.37（二）世界PCB生产基地转移分析.37第二节世界PCB领先企业在华布局分析.38一、奥地利科技与系统技术股份公司（AT&S）.38（一）企业基本情况概述.38（二）企业产品应用领域.39（三）企业经营情况分析.39（四）企业在华投资分析.39二、MULTEK公司.40（一）企业基本情况概述.40（二）企业产品应用领域.40（三）企业在华投资分析.42三、惠亚VIASYSTEMS集团.43（一）企业基本情况概述.43（二）企业产品应用领域.43（三）企业经营情况分析.43（四）企业在华投资分析.44四、森米纳集团（sanmina-SClcorporation）.44（一）企业基本情况概述.44（二）企业产品应用领域.44（三）企业经营情况分析.44（四）企业在华投资分析.45五、日本希门凯公

司CMK46 (一) 企业基本情况概述.46 (二) 企业产品应用领域.47 (三) 企业经营情况分析.47 (四) 企业在华投资分析.48六、韩国大德电子公司 (DaeDuckGDS) .49 (一) 企业基本情况概述.49 (二) 企业产品应用领域.50 (三) 企业经营情况分析.50 (四) 企业在华投资分析.50七、日本名幸集团.50 (一) 企业基本情况概述.50 (二) 企业产品应用领域.51 (三) 企业经营情况分析.51 (四) 企业在华投资分析.52八、瀚宇博德股份有限公司.52 (一) 企业基本情况概述.52 (二) 企业产品应用领域.54 (三) 企业经营情况分析.55 (四) 大陆市场投资分析.55九、台湾欣兴电子股份有限公司.55 (一) 企业基本情况概述.55 (二) 企业产品应用领域.56 (三) 企业经营情况分析.57 (四) 大陆市场投资分析.58 第三章中国印制电路板行业发展分析.59第一节印制电路板行业发展政策环境.59一、印制电路板行业监管体系.59 (一) 行业主管部门.59 (二) 行业自律组织.59二、印制电路板产业政策透析.59 (一) 《电子信息制造业“十三五”发展规划》.59 (二) 《电子基础材料和关键元器件“十三五”规划》.60 (三) 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 (2014年度) 》.61 (四) 《鼓励进口技术和产品目录 (2014年版) 》.62三、印制电路板行业标准化分析.62第二节印制电路板行业发展状况分析.63一、印制电路板制造行业发展概况.63二、印制电路板产品寿命周期分析.63三、印制电路板产品市场需求分析.64四、印制电路板行业产品结构分析.64第三节中国印制电路板市场规模分析.65一、印刷电路板行业产值规模分析.65 综观PCB产业近十年来的发展,中国因内需市场潜力与生产成本低廉等优势,吸引外资纷纷进驻,促使中国印制电路板产业在短短数年间呈现爆炸式增长,近五年来中国印制电路板产业已成为全球最大的印制电路板生产地区。2012年我国印制电路板行业实现总产值216.36亿美元,根据Prismark预测,2012-2017年中国PCB行业仍将保持增长趋势,在全球的市场地位也将继续提升,中国PCB产值年均复合增长率可达6%,高于全球平均水平2.1个百分点,到2017年总产值可达到289.72亿美元,占全球比例上升至44.13%。2010-2017年中国PCB产值二、印刷电路板配套产业规模分析.65 (一) PCB设备市场规模分析.65 (二) PCB外形加工设备规模.66 (三) PCB检测设备市场规模.66 (四) PCB辅助材料市场规模.67第四节印制电路板市场SWOT分析.67一、市场优势分析.67二、市场劣势分析.68三、市场机会分析.68四、市场威胁分析.69第五节印制电路板行业市场竞争分析.69一、印制电路板行业竞争格局.69 (一) 现有企业间竞争.69 (二) 潜在进入者分析.69 (三) 替代品威胁分析.70 (四) 供应商议价能力.70 (五) 客户的议价能力.70二、印制电路板行业集中度.71 (一) 产业集中度.71 (二) 区域集中度.71 (三) 市场集中度.71三、本土企业竞争力分析.72第四章2014-2016年中国印制电路板行业经济运行分析.73第一节2014-2016年中国印制电路板制造业发展分析.73一、2014年印制电路板制造业发展概述.73二、2015年印制电路板制造业发展概述.74三、2016年印制电路板制造业发展概述.77第二节2014-2016年印制电路板行业经济运行状况.78一、印制电路板制造业企业数量分析.78二、印制电路板制造业资产规模分析.80三、印制电路板制造业销售收入分析.83四、印制电路板制造业利润总额分析.85第三节2014-2016年印制电路板制造业运营效益分析.88一、印制电路板制造业盈利能力分析.88二、印制电

路板制造业的毛利率分析.89三、印制电路板制造业运营能力分析.91四、印制电路板制造业偿债能力分析.92第四节2010-2016年印制电路板制造业结构特征分析.94一、印制电路板制造企业经济类型分析.94（一）国有印制电路板制造企业指标分析.94（二）集体印制电路板制造企业指标分析.95（三）股份制印制电路板制造企业的指标.96（四）股份合作印制电路板制造企业指标.98（五）私营印制电路板制造企业指标分析.99（六）外资印制电路板制造企业指标分析.100二、印制电路板制造企业规模结构分析.102（一）大型印制电路板制造企业指标分析.102（二）中型印制电路板制造企业指标分析.103（三）小型印制电路板制造企业指标分析.104三、印制电路板制造业区域结构分析.106（一）东北地区印制电路板制造业分析.106（二）华北地区印制电路板制造业分析.107（三）华东地区印制电路板制造业分析.108（四）华中地区印制电路板制造业分析.109（五）华南地区印制电路板制造业分析.110（六）西南地区印制电路板制造业分析.111（七）西北地区印制电路板制造业分析.112 第五章中国印制电路板细分市场发展分析.113第一节印制电路板细分行业发展分析.113一、印制电路板行业细分结构.113二、印制电路板细分行业特征.114（一）PCB样板行业特征分析.114（二）小批量PCB行业特征.115（三）大批量PCB行业特征.116第二节印制电路板主要细分产品分析.117一、FPC（柔性电路板）.117（一）基本情况介绍.117（二）产品特点分析.117（三）产品分类情况.117（四）重要应用领域.118二、HDI.119（一）基本情况介绍.119（二）产品特点分析.119（三）重要应用领域.119（四）产品市场前景.119三、高多层板.120（一）基本情况介绍.120（二）重要应用领域.120（三）产品优势分析.121四、3G板.121（一）基本情况介绍.121（二）重要应用领域.121（三）产品优劣分析.121五、光电板.122（一）基本情况介绍.122（二）重要应用领域.122（三）产品优势分析.122六、铝基板.123（一）基本情况介绍.123（二）产品特点分析.123（三）重要应用领域.124 第六章2016年印制电路板主要应用领域市场分析.125第一节印制电路板下游应用结构分析.125第二节手机行业PCB应用分析.125一、手机产业发展分析.125二、智能手机发展分析.126三、手机PCB产值规模.127四、手机PCB的供应商.128五、手机PCB需求分析.128六、手机PCB需求潜力.129第三节液晶电视行业PCB应用分析.129一、液晶电视产业现状.129二、液晶电视PCB的供应商.131三、液晶电视PCB需求分析.131四、液晶电视PCB需求潜力.131第四节数码相机行业PCB应用分析.132一、数码相机产业现状.132二、数码相机PCB的供应商.132三、数码相机PCB需求分析.133四、数码相机PCB需求前景.133第五节计算机行业PCB应用分析.134一、计算机产业发展分析.134二、笔记本电脑发展分析.134三、计算机PCB产值规模.135四、计算机PCB的供应商.135五、计算机PCB需求分析.136六、计算机PCB需求潜力.136第六节通信设备行业PCB应用分析.138一、通信设备产业现状.138二、通信设备PCB特征分析.139三、通信设备PCB的供应商.139四、通信设备PCB需求分析.139五、通信设备PCB需求前景.140第七节汽车电子行业PCB应用分析.140一、汽车工业产业现状.140二、汽车电子PCB特征分析.141三、汽车电子PCB产业规模.142四、汽车电子PCB的供应商.142五、汽车电子PCB需求分析.143第七章2008-2016年中国印制电路板进出口状况分析数据监测分析

.144第一节四层以上的印刷电路进出口分析.144一、四层以上的印刷电路进口分析.144（一）四层以上的印刷电路进口数量分析.144（二）四层以上的印刷电路进口金额分析.144（三）四层以上的印刷电路进口来源分析.145（四）四层以上的印刷电路进口均价分析.145二、四层以上的印刷电路出口分析.146（一）四层以上的印刷电路出口数量分析.146（二）四层以上的印刷电路出口金额分析.146（三）四层以上的印刷电路出口流向分析.147（四）四层以上的印刷电路出口均价分析.147第二节四层以下印刷电路零件进口数据分析.148一、四层以下的印刷电路进口分析.148（一）四层及以下的印刷电路进口数量分析.148（二）四层及以下的印刷电路进口金额分析.148（三）四层及以下的印刷电路进口来源分析.149（四）四层及以下的印刷电路进口均价分析.149二、四层及以下的印刷电路出口分析.150（一）四层及以下的印刷电路出口数量分析.150（二）四层及以下的印刷电路出口金额分析.150（三）四层及以下的印刷电路出口流向分析.151（四）四层及以下的印刷电路出口均价分析.151

第八章2016年中国重点区域印制电路板行业竞争力分析.153第一节长三角地区印制电路板竞争力分析.153一、上海市印刷电路板市场发展分析.153（一）PCB发展环境分析.153（二）PCB产业现状分析.153（三）PCB市场竞争分析.154（四）PCB需求潜力分析.155二、江苏省印刷电路板市场发展分析.155（一）PCB发展环境分析.155（二）PCB产业现状分析.156（三）PCB市场竞争分析.157（四）PCB需求潜力分析.157三、浙江省印刷电路板市场发展分析.158（一）PCB发展环境分析.158（二）PCB产业现状分析.158（三）PCB市场竞争分析.159（四）PCB需求潜力分析.159第二节珠三角地区印制电路板竞争力分析.160一、深圳市印刷电路板市场发展分析.160（一）PCB发展环境分析.160（二）PCB产业现状分析.160（三）PCB市场优势分析.161（四）PCB需求潜力分析.162二、东莞市印刷电路板市场发展分析.162（一）PCB发展环境分析.162（二）PCB产业现状分析.163（三）PCB市场优势分析.163（四）PCB需求潜力分析.164三、惠州市印刷电路板市场发展分析.164（一）PCB发展环境分析.164（二）PCB产业现状分析.164（三）PCB市场优势分析.165（四）PCB需求潜力分析.165第三节京津地区印制电路板竞争力分析.166一、北京市印刷电路板市场发展分析.166（一）PCB发展环境分析.166（二）PCB产业现状分析.166（三）PCB市场竞争分析.167（四）PCB需求潜力分析.168二、天津市印刷电路板市场发展分析.168（一）PCB发展环境分析.168（二）PCB产业现状分析.168（三）PCB市场竞争分析.169（四）PCB需求潜力分析.170

第九章2016年中国印制电路板行业领先企业经营分析.171第一节沪士电子股份有限公司.171（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业经营优劣势分析

第二节天津普林电路股份有限公司.174（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业经营优劣势分析

第三节广东生益科技股份有限公司.178（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业经营优劣势分析

第四节广东汕头超声电子股份有限公司.183（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业经营优劣势分析

第五节广东超华科技股份有限公司.187（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（3）企业经营优劣势分析

第六节深圳丹邦科技股份有限公司.192（1）企业发展简况分析（2）企业经营情况分析（

3) 企业经营优劣势分析第七节惠州中京电子科技股份有限公司.196 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业经营优劣势分析第八节深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司.200 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业经营优劣势分析第九节金安国纪科技股份有限公司.205 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业经营优劣势分析第十节深圳崇达电路技术股份有限公司.209 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业经营优劣势分析 第十章2017-2023年中国印制电路板行业发展前景及投资机会分析.215第一节2017-2023年中国印制电路板行业发展前景.215一、印刷电路板行业发展驱动因素.215二、印刷电路板行业发展前景分析.215三、印刷电路板产业链延伸分析.216第二节2017-2023年中国印制电路板行业发展趋势.217一、印刷电路板行业整体趋势分析.217二、消费电子PCB产业发展趋势.218三、汽车电子PCB产业发展趋势.219第三节2017-2023年中国印制电路板行业市场规模预测.220一、印刷电路板行业产业规模预测分析.220二、印刷电路板配套行业产业规模预测.221 (一) PCB设备市场规模预测分析.221 (二) PCB外形加工市场规模.221 (三) PCB检测设备市场规模预测.222 (四) PCB辅助材料市场规模预测.222第十一章2017-2023年中国印制电路行业投融资风险及策略分析.224第一节2017-2023年中国印制电路行业投资环境分析.224一、印制电路行业宏观经济环境.224二、“十三五”电子元器件市场预测.225第二节2017-2023年中国印制电路行业投资机会及风险分析.226一、印制电路制造行业投资特性分析.226二、印制电路行业投资机会分析.227三、印制电路细分市场投资机会.228 (一) 消费电子PCB投资机会.228 (二) 汽车电子PCB投资机会.228 (三) 计算机PCB投资机会.229四、印制电路行业投资风险分析.229 (一) 宏观经济风险.229 (二) 市场竞争风险.230 (三) 原料价格风险.230 (四) 出口贸易风险.230 (五) 环保安全风险.230第三节2017-2023年中国印制电路行业投资策略分析.231一、印制电路板企业投融资策略分析.231二、印制电路板企业投融资渠道与选择分析.231 (一) 印制电路板企业融资方法与渠道简析.231 (二) 利用股权融资谋划企业发展机遇.233 (三) 利用政府杠杆拓展企业融资渠道.237 (四) 适度债权融资配置自身资本结构.238 (五) 关注民间资本和外资的投资动向.240第十二章中国印制电路制造企业投融资及IPO上市策略指导.241第一节印制电路制造企业境内IPO上市目的及条件.241一、印制电路制造企业境内上市主要目的.241二、印制电路制造企业上市需满足的条件.242 (一) 企业境内主板IPO主要条件.242 (二) 企业境内中小板IPO主要条件.243 (三) 企业境内创业板IPO主要条件.244三、企业改制上市中的关键问题.245第二节印制电路制造企业IPO上市的相关准备.246一、企业该不该上市.246二、企业应何时上市.246三、企业应何地上市.247四、企业上市前准备.247 (一) 企业上市前综合评估.247 (二) 企业的内部规范重组.247 (三) 选择并配合中介机构.248 (四) 应如何选择中介机构.248第三节印制电路制造企业IPO上市的规划实施.248一、上市费用规划和团队组建.248二、尽职调查及问题解决方案.252三、改制重组需关注重点问题.256四、企业上市辅导及注意事项.258五、上市申报材料制作及要求.260六、网上路演推介及询价发行.262第四节企业IPO上市审核工作流程.263一、企业IPO上市基本审核流程.263二、

企业IPO上市具体审核环节.264三、与发行审核流程相关的事项.267

图表目录：图表1印制电路板基本组成一览.20图表2按不同方式分类的PCB产品分类.21图表3PCB生产阶段.21图表4PCB样板产业链.22图表52012-2016年中国玻璃纤维纱产量规模增长趋势图.23图表62016年中国玻璃纤维纱产量分布.23图表72016年中国各省市玻璃纤维纱产量统计.24图表82013-2016年全球压延铜箔销售情况.27图表9中国各类覆铜板产量统计表.28图表10中国覆铜板对铜箔的需求量.28图表112012-2016年全球PCB产值规模增长趋势图.34图表12全球PCB设备市场规模增长趋势图.35图表13全球PCB外形加工设备市场规模增长趋势图.35图表14全球PCB检测设备市场规模增长趋势图.36图表15全球PCB辅助材料市场规模增长趋势图.37图表16世界PCB产业企业分布格局.37图表172012-2016年AT&S销售收入和毛利润统计.39图表18MULTEK生产的产品在汽车方面的应用.41图表19MULTEK生产的产品在通讯设备方面的应用.41图表20MULTEK生产的产品在医疗设备方面的应用.42图表21MULTEK生产的产品在高端计算和基础设施的应用.42图表222016年惠亚集团收入与利润统计.43图表232013-2016年惠亚集团净销售额情况统计.44图表242016年森米纳集团收入与利润统计.45图表252013-2016年森米纳集团总收入情况统计.45图表26森米纳集团Sanmina全球网络分布图.46图表27日本希门凯公司发展及海外扩张过程.46图表282013-2015年日本希门凯公司收入及利润统计.47图表292013财年日本希门凯公司营业收入结构情况表.48图表302013-2015年日本希门凯公司营业收入分地区情况表.48图表31日本希门凯电子公司中国事业所介绍.48图表32日本希门凯公司在中国的事业部及其产品介绍.49图表332013-2016年韩国大德电子公司收入与利润统计.50图表342013-2015年日本名幸集团收入与利润情况统计.51图表35瀚宇博德股份有限公司竞争力分析.53图表36瀚宇博德股份有限公司组织结构图.54图表37瀚宇博德股份有限公司印刷电路板应用端产品分类.54图表382013-2016年瀚宇博德股份有限公司营业收入情况统计.55图表39台湾欣兴电子股份有限公司组织结构图.56图表40台湾欣兴电子股份有限公司产品介绍.57图表412013-2016年台湾欣兴电子股份有限公司收入与利润情况统计.57图表42台湾欣兴电子股份有限公司生产基地分布情况.58图表43台湾欣兴电子股份有限公司生产基地分布图.58图表44中国印制电路板行业相关标准一览.62图表45PCB各产品生命周期曲线示意图.64图表462012-2016年中国PCB产值规模增长趋势图.65图表47中国大陆PCB设备市场规模增长趋势图.66图表48中国PCB外形加工设备市场规模增长趋势图.66图表49中国PCB检测设备市场规模增长趋势图.67图表50中国PCB辅助材料市场规模增长趋势图.67图表51中国印制电路板制造行业企业分布格局.71图表52中国印制电路板制造企业百强榜单（前二十位）.72.....图表862013-2016年中国印制电路板制造业应收账款周转率情况.91图表872013-2016年中国印制电路板制造业流动资产周转率情况.92图表882013-2016年中国印制电路板制造企业行业总资产周转率情况.92图表892013-2016年中国印制电路板制造业资产负债率情况.93.....图表130样板、小批量PCB和大批量PCB的应用领域细分情况.113图表131印制电路板细分行业结构.114图表132PCB行业大批量订单和小批量

订单.115图表133PCB样板与批量板模式对比.115图表134柔性电路板产品特点一览.117图表135柔性电路板根据导体的层数和结构分类情况.118图表136柔性电路板重要应用领域一览.118图表1372012-2016年主要年份HDI市场情况.120图表138光学PCB和传统PCB的特点比较.123图表139铝基板主要用途一览.124图表1402012-2016年中国移动通信手持机产量统计.126图表1412013-2016年中国智能手机出货量统计.127图表1422012-2016年全球通讯领域电子系统及PCB产值情况.128图表143全球主要手机PCB厂商一览.128图表1442016年中国液晶电视市场不同背光等类型产品关注比例分布.130图表1452016年中国液晶电视市场不同尺寸产品关注比例分布.130图表1462013-2016年中国液晶电视机产量统计.131图表147液晶电视PCB主要供应商一览.131图表1482013-2016年中国数码相机产量统计.132图表149数码相机PCB主要供应商一览.133图表1502012-2016年中国微型计算机设备产量统计.134图表1512012-2016年中国笔记本计算机产量统计.135图表1522012-2016年主要年份计算机领域电子系统及PCB产值情况.135图表153全球笔记本电脑PCB厂商市场占有率情况.136图表1542012-2016年中国电信业固定资产投资完成额统计.138图表1552012-2016年中国移动通信基站设备产量统计.139图表156通信设备PCB主要供应商一览.139图表1572012-2016年中国汽车产销量统计.141图表1582012-2016年主要年份世界汽车PCB产值变化情况.142图表1592013-2016年四层以上印刷电路进口数量统计.144图表1602013-2016年四层以上印刷电路进口金额统计.144图表1612016年四层以上印刷电路进口来源地情况.145图表1622013-2016年四层以上印刷电路进口均价统计.146图表1632013-2016年四层以上印刷电路出口数量统计.146图表1642013-2016年四层以上印刷电路出口金额统计.146图表1652016年四层以上印刷电路出口流向情况.147图表1662013-2016年四层以上印刷电路出口均价统计.147图表1672013-2016年四层以下印刷电路进口数量统计.148图表1682013-2016年四层以下印刷电路进口金额统计.149图表1692016年四层以下印刷电路进口来源地情况.149图表1702013-2016年四层以下印刷电路进口均价统计.150图表1712013-2016年四层以下印刷电路出口数量统计.150图表1722013-2016年四层以下印刷电路出口金额统计.150图表1732016年四层以下印刷电路出口流向情况.151图表1742013-2016年四层以下印刷电路出口均价统计.151.....图表1852016年沪士电子股份有限公司主营业务分产品情况表.171图表1862016年沪士电子股份有限公司主营业务结构情况.172图表1872013-2016年沪士电子股份有限公司收入与利润统计.172图表1882013-2016年沪士电子股份有限公司资产与负债统计.172图表1892013-2016年沪士电子股份有限公司盈利能力情况.173图表1902013-2016年沪士电子股份有限公司偿债能力情况.173图表1912013-2016年沪士电子股份有限公司运营能力情况.174图表1922013-2016年沪士电子股份有限公司成本费用统计.174图表1932016年天津普林电路股份有限公司主营业务分产品情况表.175图表1942016年天津普林电路股份有限公司主营业务结构情况.175图表1952016年天津普林电路股份有限公司主营业务分地区情况表.176图表1962013-2016年天津普林电路股份有限公司收入与利润统计.176图表1972013-2016年天津普林电路股份有限公司资产与负债统计.176图表1982013-2016年天津普林电路股份有限公司盈

利能力情况.177图表1992013-2016年天津普林电路股份有限公司偿债能力情况.177图表200  
2013-2016年天津普林电路股份有限公司运营能力情况.177图表2012013-2016年天津普林  
电路股份有限公司成本费用统计.178图表2022016年生天津普林电路股份有限公司成本费用  
结构图.178图表2032016年广东生益科技股份有限公司主营业务分行业情况表.180图表2042  
016年广东生益科技股份有限公司主营业务结构情况.180图表2052016年广东生益科技股份  
有限公司主营业务分地区情况表.180图表2062013-2016年广东生益科技股份有限公司收入  
与利润统计.180图表2072013-2016年广东生益科技股份有限公司资产与负债统计.181图表2  
082013-2016年广东生益科技股份有限公司盈利能力情况.181图表2092013-2016年广东生  
益科技股份有限公司偿债能力情况.182图表2102013-2016年广东生益科技股份有限公司运  
营能力情况.182图表2112013-2016年广东生益科技股份有限公司成本费用统计.182图表212  
2016年广东生益科技股份有限公司成本费用结构图.183图表2132016年广东汕头超声电子股  
份有限公司主营业务分产品情况表.184图表2142016年广东汕头超声电子股份有限公司主营  
业务结构情况.184图表2152016年广东汕头超声电子股份有限公司主营业务分地区情况表.1  
84图表2162013-2016年广东汕头超声电子股份有限公司收入与利润统计.185图表2172013-  
2016年广东汕头超声电子股份有限公司资产与负债统计.185图表2182013-2016年广东汕头  
超声电子股份有限公司盈利能力情况.185图表2192013-2016年广东汕头超声电子股份有限  
公司偿债能力情况.186图表2202013-2016年广东汕头超声电子股份有限公司运营能力情况.  
186图表2212013-2016年广东汕头超声电子股份有限公司成本费用统计.186图表2222016年  
广东汕头超声电子股份有限公司成本费用结构图.187图表2232016年广东超华科技股份有限  
公司主营业务分产品情况表.188图表2242016年广东超华科技股份有限公司主营业务结构情  
况.188图表2252016年广东超华科技股份有限公司主营业务分地区情况表.189图表2262013-  
2016年广东超华科技股份有限公司收入与利润统计.189图表2272013-2016年广东超华科技  
股份有限公司资产与负债统计.189图表2282013-2016年广东超华科技股份有限公司盈利能  
力情况.190图表2292013-2016年广东超华科技股份有限公司偿债能力情况.190图表230201  
3-2016年广东超华科技股份有限公司运营能力情况.191图表2312013-2016年广东超华科技  
股份有限公司成本费用统计.191图表2322016年广东超华科技股份有限公司成本费用结构图.  
191图表2332016年深圳丹邦科技股份有限公司主营业务分行业分产品情况表.193图表2342  
016年深圳丹邦科技股份有限公司主营业务结构情况.193图表2352016年深圳丹邦科技股份  
有限公司主营业务分地区情况表.193图表2362013-2016年深圳丹邦科技股份有限公司收入  
与利润统计.194图表2372013-2016年深圳丹邦科技股份有限公司资产与负债统计.194图表2  
382013-2016年深圳丹邦科技股份有限公司盈利能力情况.194图表2392013-2016年深圳丹  
邦科技股份有限公司偿债能力情况.195图表2402013-2016年深圳丹邦科技股份有限公司运  
营能力情况.195图表2412013-2016年深圳丹邦科技股份有限公司成本费用统计.195图表242  
2016年深圳丹邦科技股份有限公司成本费用结构图.196图表2432016年惠州中京电子科技股  
份有限公司主营业务分产品情况表.197图表2442016年惠州中京电子科技股份有限公司主营

业务结构情况.198图表2452016年惠州中京电子科技股份有限公司主营业务分地区情况表.198图表2462013-2016年惠州中京电子科技股份有限公司收入与利润统计.198图表2472013-2016年惠州中京电子科技股份有限公司资产与负债统计.199图表2482013-2016年惠州中京电子科技股份有限公司盈利能力情况.199图表2492013-2016年惠州中京电子科技股份有限公司偿债能力情况.199图表2502013-2016年惠州中京电子科技股份有限公司运营能力情况.200图表2512013-2016年惠州中京电子科技股份有限公司成本费用统计.200图表2522016年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司主营业务分产品情况表.202图表2532016年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司主营业务结构情况.202图表2542016年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司主营业务分地区情况表.202图表2552013-2016年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司收入与利润统计.203图表2562013-2016年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司资产与负债统计.203图表2572013-2016年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司盈利能力情况.203图表2582013-2016年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司偿债能力情况.204图表2592013-2016年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司运营能力情况.204图表2602013-2016年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司成本费用统计.204图表2612016年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司成本费用结构图.205图表2622016年金安国纪科技股份有限公司主营业务分产品情况表.206图表2632016年金安国纪科技股份有限公司主营业务结构情况.206图表2642016年金安国纪科技股份有限公司主营业务分地区情况表.207图表2652013-2016年金安国纪科技股份有限公司收入与利润统计.207图表2662013-2016年金安国纪科技股份有限公司资产与负债统计.207图表2672013-2016年金安国纪科技股份有限公司盈利能力情况.208图表2682013-2016年金安国纪科技股份有限公司偿债能力情况.208图表2692013-2016年金安国纪科技股份有限公司运营能力情况.208图表2702013-2016年金安国纪科技股份有限公司成本费用统计.209图表271深圳市崇达电路技术股份有限公司印制电路板产品情况表.209图表272深圳市崇达电路技术股份有限公司印制电路板产品图.210图表273深圳市崇达电路技术股份有限公司资产及收入统计.211图表274深圳市崇达电路技术股份有限公司营销网络分布图.212图表275深圳市柳鑫实业有限公司印制电路板产品情况表.212图表276深圳市柳鑫实业有限公司资产及收入统计.213图表277全球电子产业未来发展驱动因素.215图表2782013-2022年中国印制电路板行业市场规模预测趋势图.221图表2792013-2022年中国PCB设备市场规模预测趋势图.221图表2802013-2022年中国PCB外形加工设备市场规模预测趋势图.222图表2812013-2022年中国PCB检测设备市场规模预测趋势图.222图表2822013-2022年中国PCB辅助材料市场规模预测趋势图.223图表283印制电路板企业融资方式与渠道分类.232图表284风险投资和私募股权的主要区别.235图表285创投及私募股权投资基金运作程序.236图表286印刷电路板企业IPO上市网上路演的主要事项.262图表287印刷电路板企业IPO上市基本审核流程图.264

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/323967.html>